

股票代码：688403

股票简称：汇成股份

合肥新汇成微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2024年1月31日)

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	国联证券、汇丰晋信基金、泰康基金、嘉合基金、永赢基金。 (排名不分先后)
活动时间	2024年1月31日
活动地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 奚颢 投关经理 齐博
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、问：2023年Q4公司整体经营情况如何？</p> <p>答：2023年Q4情况整体与前两个季度情况相近，订单饱和度相对较高，公司12吋封测制程整体稼动率维持在相对较高水平。</p> <p>2、问：2024年Q1公司订单景气度及产能利用率情况如何？</p> <p>答：受下游面板行业景气周期影响，叠加春节放假等因素，Q1属于业内传统淡季，订单饱和度有所回落，Q1内稼动率水平预计环比略有下滑，与过往行业周期波动的规律相符。由于2023年Q1属于行业景气度相对较低的阶段，</p>

	<p>稼动率水平相对较低，因此 2024 年 Q1 稼动率水平相较于去年同期预计仍能维持增长态势。</p> <p>3、问：公司可转债募投项目目前的实施进展情况如何？公司最新扩产情况及相关设备交期情况如何？</p> <p>答：公司可转债预案于 2023 年 6 月经董事会决议通过后，公司已使用自有或自筹资金先行投入，提前锁定募投项目相关设备的交期，12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目及 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目投产后形成的新增产能预计将于 2024 年上半年起逐步释放。募投项目相关设备已根据公司订单及客户产能需求情况安排好相应的进机时间，设备交付情况良好。</p> <p>4、问：公司所布局的 OLED DDIC 产能扩充，其产线能否和其他品类显驱业务共用？</p> <p>答：不同类别的 DDIC 产品所使用的封测制程工艺原理相似，使用设备根据终端应用及客户需求情况存在一定程度的重合。主要区别在于 OLED 及少部分 TDDI 等高端制程产品需要使用非接触式镭射切割（Laser grooving）技术，并且对测试机台的测试频率、测试 pin 数量等性能指标要求较高，OLED 等高阶制程的测试机台可以向下兼容。</p> <p>5、问：公司 OLED 产品当前营收占比及后续展望？</p> <p>答：公司 OLED 产品封测业务营收占比呈现逐季提升的态势，下游需求相对较为旺盛，结合 OLED 屏幕在手机端渗透率持续提升以及在笔电、平板等更多终端应用提升的市场情况，预计 2024 年内 OLED 产品封测业务营收占比有望持续增长。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>无</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>

上传日期	2024 年 2 月 1 日
------	----------------